

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 10 月 4 日(04.10.2012)



(10) 国際公開番号
WO 2012/133418 A1

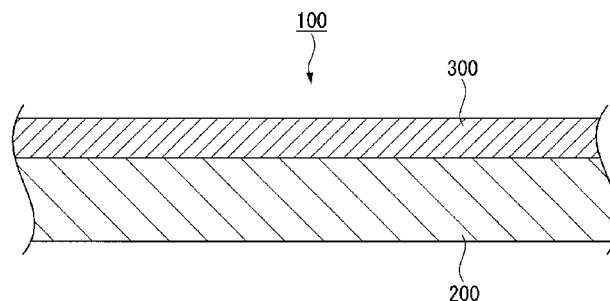
- (51) 国際特許分類:
C09J 7/02 (2006.01) C09J 201/08 (2006.01)
C09J 4/00 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
C09J 175/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/057952
- (22) 国際出願日: 2012 年 3 月 27 日(27.03.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-075003 2011 年 3 月 30 日(30.03.2011) JP
特願 2012-003125 2012 年 1 月 11 日(11.01.2012) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友
ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE
CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川
2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石破 彰浩
(ISHIBA Akihiro) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区
東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式
会社内 Tokyo (JP). 磯部 雅俊 (ISOBE Masatoshi)
[JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5
番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo
(JP). 長尾 佳典 (NAGAO Yoshinori) [JP/JP]; 〒
1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号
住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 棚井 澄雄, 外 (TANAI Sumio et al.); 〒
1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号
Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA,
RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,
SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE TAPE FOR PROCESSING SEMICONDUCTOR WAFER ETC.

(54) 発明の名称: 半導体ウエハ等加工用粘着テープ

[図1]



(57) Abstract: The issue of the present invention is to provide an adhesive tape for processing semiconductor wafers and the like, with which a quantity of an adhesive left on the surface of a material that has had a tape adhered thereon can be sufficiently reduced after the tape is peeled. An adhesive tape (100) for processing semiconductor wafers and the like is provided with a base material layer (200), and an adhesive layer (300). The adhesive layer (300) is formed at least on one surface of the base material layer (200). Furthermore, the adhesive layer (300) is mainly composed of a carboxyl group-containing polymer. The carboxyl group-containing polymer contains a radiation polymerizable compound (specifically, urethaneacrylate).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/133418 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

本発明の課題は、テープ剥離後の被着体の表面に残る粘着剤の量を十分に低減させることができる半導体ウエハ等加工用粘着テープを提供することである。本発明に係る半導体ウエハ等加工用粘着テープ（１００）は、基材層（２００）と、粘着層（３００）とを備える。粘着層（３００）は、基材層（２００）の少なくとも一方の面に形成される。また、粘着層（３００）は、主に、カルボキシル基含有ポリマーから成る。カルボキシル基含有ポリマーは、放射線重合化合物（特に、ウレタンアクリレート）を含有する。